

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年1月25日 (2018.1.25)

【公開番号】特開2017-17048(P2017-17048A)

【公開日】平成29年1月19日 (2017.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2017-003

【出願番号】特願2015-128756(P2015-128756)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

H 0 5 K 1/02 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 3/46 N

H 0 5 K 3/46 Z

H 0 5 K 1/02 E

H 0 5 K 3/46 B

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月11日 (2017.12.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

第 1 絶縁層と、

前記第 1 絶縁層の下面に積層された第 1 配線層と、

前記第 1 絶縁層の下面に積層され、前記第 1 配線層が形成される配線形成領域よりも外側に位置する外周領域に形成された第 1 補強パターンと、

前記第 1 配線層及び前記第 1 補強パターンを被覆するように前記第 1 絶縁層の下面に積層された第 2 絶縁層と、

前記第 2 絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第 1 補強パターンに接して形成された第 1 補強ビアと、

前記第 1 補強ビアを介して前記第 1 補強パターンと接続され、前記第 2 絶縁層の下面に積層された第 2 補強パターンと、を有し、

前記第 1 補強ビアの底部の一部が、前記第 1 絶縁層に食い込んで形成されていることを特徴とする配線基板。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 7 】

本発明の一観点によれば、第 1 絶縁層と、前記第 1 絶縁層の下面に積層された第 1 配線層と、前記第 1 絶縁層の下面に積層され、前記第 1 配線層が形成される配線形成領域よりも外側に位置する外周領域に形成された第 1 補強パターンと、前記第 1 配線層及び前記第 1 補強パターンを被覆するように前記第 1 絶縁層の下面に積層された第 2 絶縁層と、前記第 2 絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第 1 補強パターンに接して形成された第 1 補強ビアと、前記第 1 補強ビアを介して前記第 1 補強パターンと接続され、前記第 2 絶縁層の下面に積層された第 2 補強パターンと、を有し、前記第 1 補強ビアの底部の一部が、前記第 1

絶縁層に食い込んで形成されている。